

2024年机器视觉暨智能传感技术与峰会、机器视觉设备展会

产品名称	2024年机器视觉暨智能传感技术与峰会、机器视觉设备展会
公司名称	中国（耀瀚）展会信息
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	17810353883 17810353883

产品详情

SEMI-e2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会

展览时间：2024年06月26-28日展览地点：深圳市国际会展中心（宝安新馆）

组织架构

主办单位

中国通信工业协会

浙江省半导体行业协会

成都市集成电路行业协会

江苏省半导体行业协会

深圳市半导体行业协会

深圳市中新材会展有限公司

深圳半导体展展示了半导体领域的和产品，为推动整个产业的发展发挥了积极作用。虽然半导体市场已经进入了调整期，但是随着新技术的不断涌现和应用场景的不断扩展，半导体产业的前景仍然十分广阔。未来，各家企业需要继续加强技术创新和市场拓展，共同推动整个产业的发展。

2024第六届SEMI-e 深圳国际半导体技术暨应用展览会定档于2024年6月26日-6月28日在深圳国际会展中心（宝安新馆）举行！为产业链的升阶发展搭建供需对接、双向奔赴的平台，探索半导体行业发展新路径，共掘半导体行业新风口！

除了技术创新外，深圳半导体展还注重于产业生态建设。在展会期间，各家企业不仅展示了他们的技术和产品，还就未来的发展趋势、市场机遇等方面进行了深入的探讨和交流。这些交流不仅有助于各家企业更好地把握市场机遇，也有助于推动整个半导体产业的发展。它将为产业链上的各个环节提供交流与合作的平台，促进技术创新和市场拓展，为产业发展注入新的活力。

展示范围1、设计、芯片、晶圆制造与封装：集成电路设计及芯片、晶圆制造、SiP先进封装、功率器件封测、MEMS封测、硅晶圆及IC封装基板、封装基板与应用制造与封测、EDA、MCU、封装基板半导体材料与设备及零部件等

2、先进材料：硅片及硅基材料、光掩模板、电子气体、光刻胶及其配套试剂、CMP抛光材料、靶材、封装基板、引线框架、键合丝、陶瓷基板、芯片粘合材料等

3、IC载板/陶瓷基板：IC载板及封装工艺(基板、铜等结构材料及干膜、金盐等化学品/耗材) Chiplet封装技术、存储、MEMS及芯片应用及材料、设备。陶瓷基板与封装材料及设备等

4、半导体显示/Mini/Micro-LED：OLED、AMOLED、Mini/Micro LED显示、柔性显示与材料及设备等

5、半导体专用设备&零部件：减薄机、单品炉、研磨机、热处理设备、光刻机、刻蚀机、离子注入设备、CVD/PVD设备、清洗设备切割机、装片机、键合机、测试机、分选机、探针台及零部件等

6、第三代半导体：氮化(GaN)和碳化硅(SiC)、氧化锌(ZnO)、金刚石、晶圆、衬底与外延、功率器件、IGBT封装材料、射频器件及加工设备等

7、元器件：无源器件、半导体分立器件/IGBT、5G核心元器件特种电子、元器件。电源管理、传感器、存储器、连接器继电器、线缆、接插器件、晶振、电阻、显示器件、二极管、三极管滤波元件、开关及元器件材料及设备等

8、机器视觉与传感器：各类感知元件、执行器、智能传感器、工业传感器、传感器芯片、传感器生产与制造设备、配件等

9：电源&储能技术：储能电源及传感器、电池管理芯片、功率半导体器件及材料和相关设备、仪器及零部件等

10、毫米波雷达/激光雷达/自动驾驶：毫米波雷达模组、射频芯片、天线及高频PCB、高频材料、生产组装设备等汽车雷达传感器上下游供应链各环节产品等

11、微电子综合智造区：电子自动化、机器自动化、视觉检测、环保、清洗设备、检测设备、测试仪器、配件等

12、AI与算力、算法、存储、CPO共封装：人工智能芯片、方案、算力芯片及方案、算法方案数据存储、光电共封装模块及技术和设备等

13、汽车半导体/车规级先进封装技术：车规级半导体主控/计算类芯片、功率半导体(IGBT和MOSFET)、车规级SiC模块、电源管理芯片、汽车电子微组装及功率器件、封装测试设备、自动化设备、国际半导体材料商、设备商、封测、制造、代工厂商等

作为全球半导体产业的重要盛会，深圳半导体展会一直秉承着“创新、合作、共赢”的理念，致力于推动全球半导体产业的持续发展。我们相信，在展会期间，您将能够结识到来自世界各地的业界精英，共同探讨半导体产业的未来发展方向，为产业的繁荣发展贡献力量。

在展会期间，我们将为参展商和观众提供全方位的服务和支持，确保大家能够充分展示自己的成果、交流心得和获取商机。同时，我们还将加强与其他国家和地区的合作与交流，共同推动全球半导体产业的协同发展。